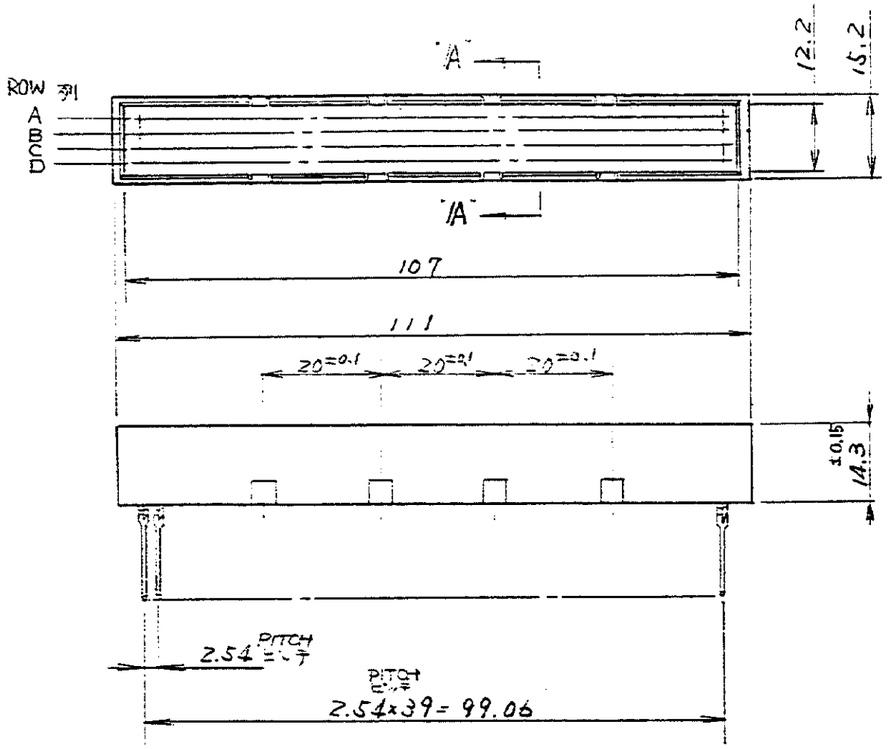
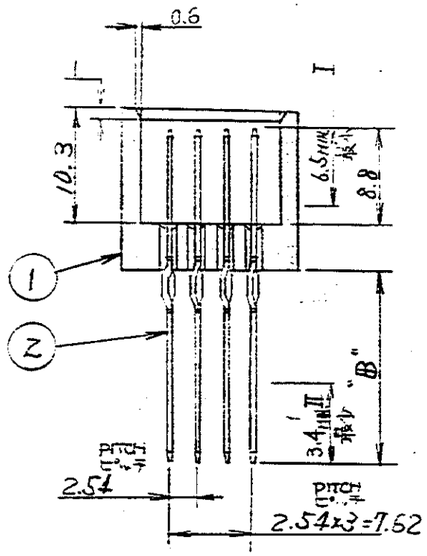




SECT "A-A"

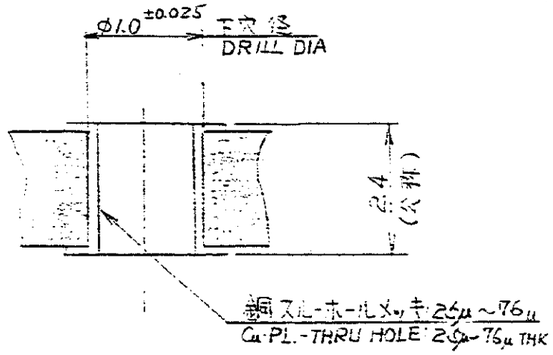
注記

1. 1.3μ以上のニッケルメッキの上にIの範囲に0.76μ最小の金メッキ，IIの範囲及びアクション部に0.1μ最小の金メッキを施す
2. 1.3μ以上のニッケルメッキの上にIの範囲に0.76μ最小の金メッキ，アクション部に0.1μ最小の金メッキを施す.
3. -3,-6はA,B,C列のみコンタクトを挿入してある
4. -4,-5はA,B列のみコンタクトを挿入してある.

NOTES

1. 1.3μ MIN. NICKEL UNDER PL. 0.76μ MIN. GOLD PL. IN ZONE I. 0.1μ MIN. GOLD PL. IN ZONE II AND ACTION AREA
2. 1.3μ MIN. NICKEL UNDER PL. 0.76μ MIN. GOLD PL. IN ZONE I. 0.1μ MIN. GOLD PL. IN ACTION AREA.
3. -3,-6: INSERT CONTACTS ROW A, B, C ONLY
4. -4,-5: INSERT CONTACTS ROW A, B ONLY

5. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



基板穴推奨寸法
RECOMENDED HOLE SIZE

5	4	3	2	1	寸法 DIM "B"	仕上 FINISH	材料 MATERIAL	名称 NAME	ITEM NO.
80	120	160	—		9.4 REF.	2	↑	↑	2
120	80	—	—	160	16.9 REF.	1	銅合金 COPPER ALLOY	アクションピンポスト ACTION PIN POST	2
1	1	1	1	1	—	—	ガラス入り PBT GRASS FILLED PBT	ハッダーハウジング HDR-HSG	1
-6	-5	-4	-3	-2	-1				

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
B1	REVISED PER ECO-09-022424	KK		01/09/09
B	-5 自加 J10980	H.A	T.Sa	10/3/09
A	-6 追加 J12080	H.A	T.Sa	10/3/09
0	作成 J9696	T.Sa	T.Sa	2-3-09

© 1997年 日本エー・エム・ピー株式会社
© 1987BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN

配合電線断面積(WIRE RANGE)	mm²(AWG)
被覆外径 (INSULATION DIA.)	mm
材料 (MATERIAL)	SEE TABLE 表参照
仕上 (FINISH)	SEE TABLE 表参照
DR.	
DE.	
CHK.	2-4-09
APP.	2-4-09

名称 (NAME): HDR ASS'Y S-200 CONN.

一般公差: 10以下 ±0.2; 10を超え 30以下 ±0.25; 30を超え 100以下 ±0.3; 角 度 ±3°

SYZE	LOC	番号 (NO.)
C	J	C-174350

尺度 (SCALE)	REV.	SHEET
—	B1	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT